순번 **3**

기술명

디아민 화합물, 이로부터 형성된 폴리아믹산과 폴리이미드 및 폴리이미드를 포함한 폴리이미드 필름

- 특 허 번 호 : 10-2017-0146182
- 보 유 기 관 : 한국과학기술연구원
- 패밀리정보 : 없음
- 패키징특허 : 10-2017-0044971

기술개요

- 신규한 디아민 화합물, 이로부터 형성된 폴리아믹산과 폴리이미드, 폴리이미드를 포함한 폴리이미드 필름에 대한 기술
- 활용처 : 반도체, 디스플레이, Solar Cell, 자동차 및 일반산업분야 소재

기존 한계점

- 복합재료는 화학적 안정성이 낮으며 광 투과도가 저하되는 문제점을 가짐
- 고도화된 집적 소자에 적용될 만큼 우수한 폴리이미드 필름을 제공하지 못함

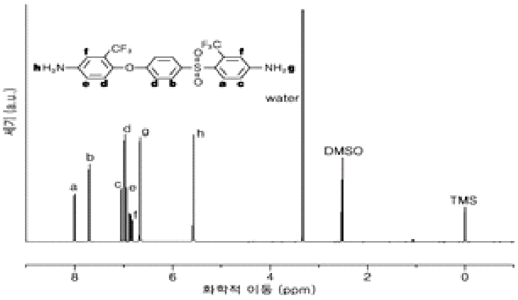
기술 차별점

- 디아민 화합물로부터 형성된 폴리아믹산과 폴리아믹산으로부터 얻어지고 용매에 대한 용해도 특성이 우수한 폴리이미드를 제공
- 폴리이미드를 함유하여 광투과성과 내열성이 우수한 폴리이미드 필름을 제공

세 부 내 용

- 디아민 화합물은 에테르와 술폰 그룹을 다수 포함하므로 구조적으로 매우 유연하며, 화학적 안정성이 매우 높음
- 반복단위 구조 내에 존재하는 트리플루오로메틸 그룹으로 광 투과성 및 가공성을 향상시킬 수 있는 용해도를 크게 향상

대표 이미지



문 의 처

- 국가과학기술연구회 공동TLO마케팅사무국 엄예지 선임연구원
- T. 042-862-6986 E-mail. yjeum@wips.co.kr